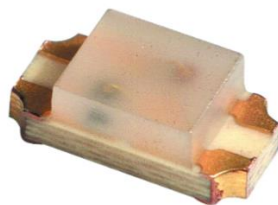




SPECIFICATIONS
SPEZIFIKATIONEN

OLS-136 MR/HY-XD-TD



Features:

- size 1206: 3,2(L) x 1,6(W) x 1,2(H) mm
- circuit substrate: glass laminated epoxy
- devices are ROHS and REACH conform
- lead free solderable, soldering pads: gold plated
- taped in 8 mm blister tape, cathodes
- positions to transporting perforation
- all devices sorted into intensity classes
- taping: face-up (T) or face-down (TD) possible

Merkmale:

- Größe: 3,2 x 1,6 x 1,2 mm
- Trägerstreifen: Glasfaserlaminat
- Bauteile sind ROHS und REACH konform
- Bleifrei lötbar, Löt pads: vergoldet
- Gegurtet in 8mm Blistergurt, Kathoden zur Transportperforation
- Alle Bauteile in Intensitätsklassen sortiert
- Gurtung: Face-up (T) und Face-down (TD) möglich

• Typical Electro-Optical Characteristics

Typische Elektrooptische Eigenschaften

Measurement conditions
Messbedingungen

$T_{\text{ambient}} = 23\text{ °C}$; $t_{\text{test}} \leq 60\text{ms}$

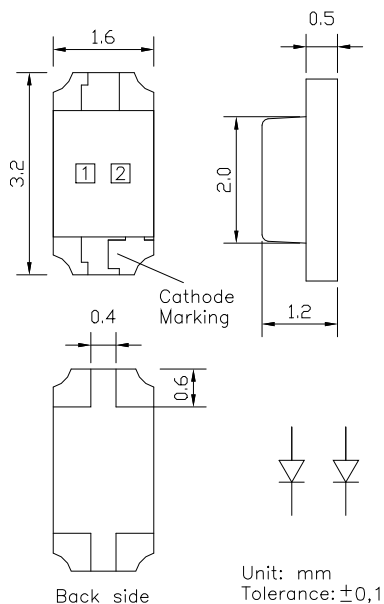
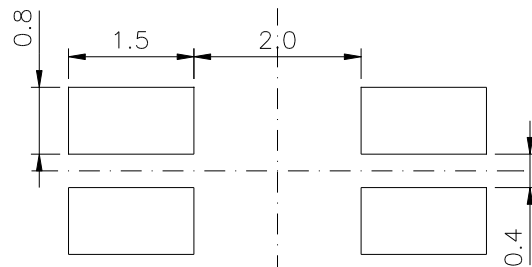
Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Emitting Color Farbe			Red / Yellow Rot / Gelb			
Forward Voltage ⁽²⁾ Flussspannung	U_f	$I_f = 2\text{ mA}^{(2)}$	red/rot	1.81	2.20	V
			yellow/gelb	1.84	2.60	
		$I_f = 20\text{ mA}$	red/rot	2.04	2.40	
			yellow/gelb	2.00	2.60	
Dominant Wavelength ⁽²⁾ Dominante Wellenlänge	λ_D	$I_f = 2\text{ mA}$	red/rot	620	630	nm
			yellow/gelb	580	590	
FWHM ⁽¹⁾ Halbwertsbreite	$\Delta\lambda$	$I_f = 20\text{ mA}$	red/rot	23		nm
			yellow/gelb	12		
Luminous Intensity ⁽¹⁾ Lichtstärke	I_v	$I_f = 2\text{ mA}$	red/rot	1.80	4.30	mcd
			yellow/gelb	9.0	15.5	
Reverse Current ⁽²⁾ Sperrstrom	I_R	$U_R = 5\text{ V}$	red/rot		100	μA
			yellow/gelb		100	

(1) Typical property, not 100% tested

(2) 100% measured in an automated test system with max 60 ms operation

- Maximum Ratings**
Grenzwerte

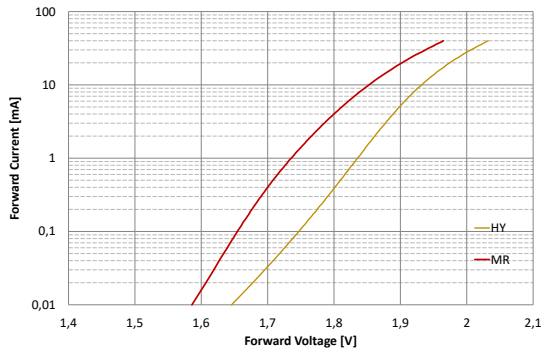
Parameter	Symbol	Min	Max	Unit
Power Dissipation, max. Verlustleistung, max.	PD, max		65	mW
Forward Current, pulsed Flussstrom, gepulst $t_p \leq 100\mu s, \tau = 1:10$	$I_{f, pulse}$		50	mA
Reverse Voltage Sperrspannung	U_R		5	V
Thermal Resistance, Junction - Soldering Wärmewiderstand, Sperrschicht - Lötstelle	$R_{th_{JS}}$		450	K/W
Operating Temperature Betriebstemperatur	T_{op}	-40	+85	°C
Storage Temperature Lagertemperatur	T_{st}	-40	+85	°C

Outline Drawing
Zeichnung

Recommended Soldering Pad
Empfohlenes Lötpad


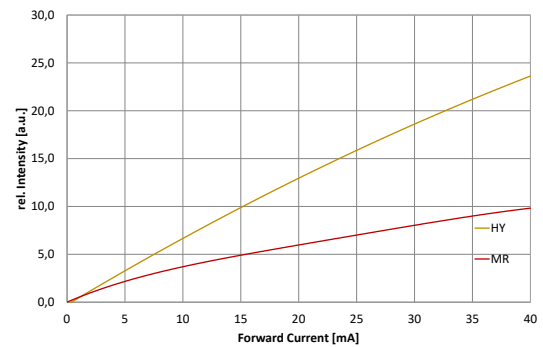
Marking at cathode of HY
Markierung an der Kathode der HY

Chip 1: MR – red /rot
Chip 2: HY – yellow /gelb

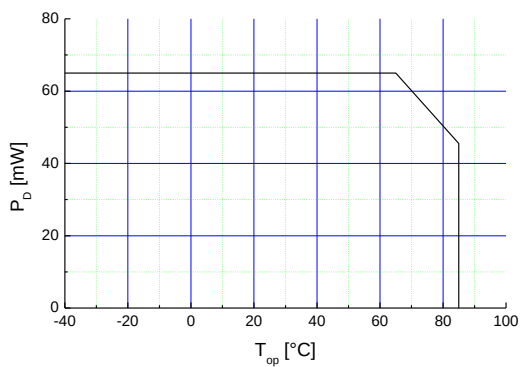
• Typical Performance Diagram Typische Kennlinien



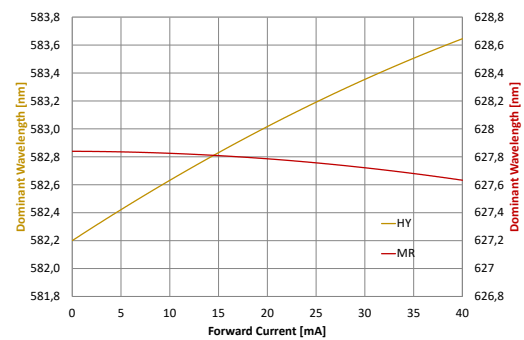
Forward Current vs. Forward Voltage
Flussstrom über Flussspannung



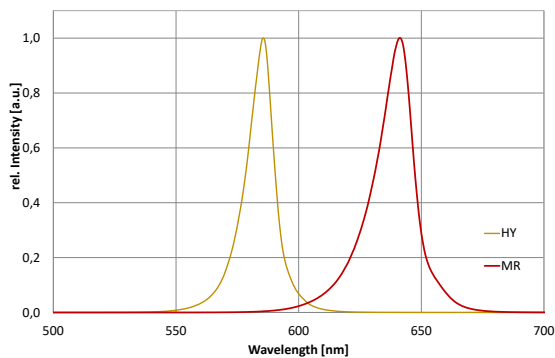
Intensity vs. Forward Current
Lichtstärke über Flussstrom



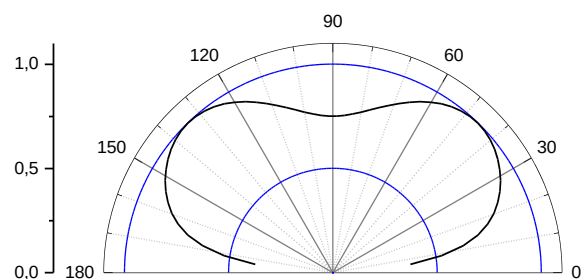
Max. Dissipation Power vs. Ambient Temperature
Max. Verlustleistung über Umgebungstemperatur



Shift Dominant Wavelength vs. Forward Current
Verschiebung der Wellenlänge über Flussstrom

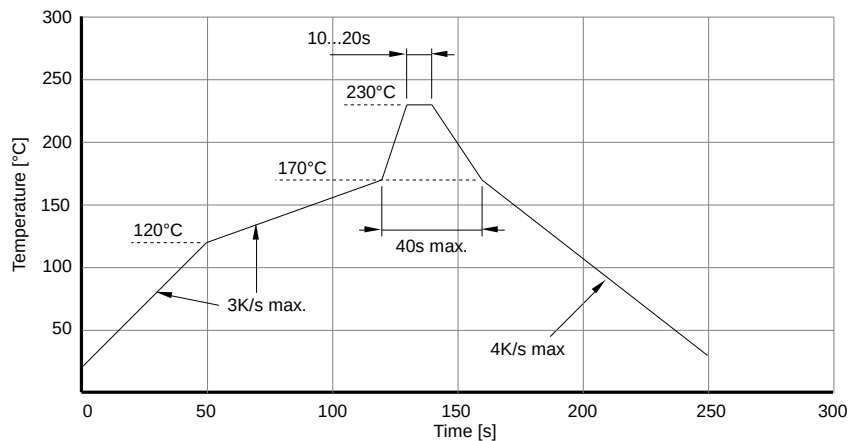


Spectrum
Spektrum



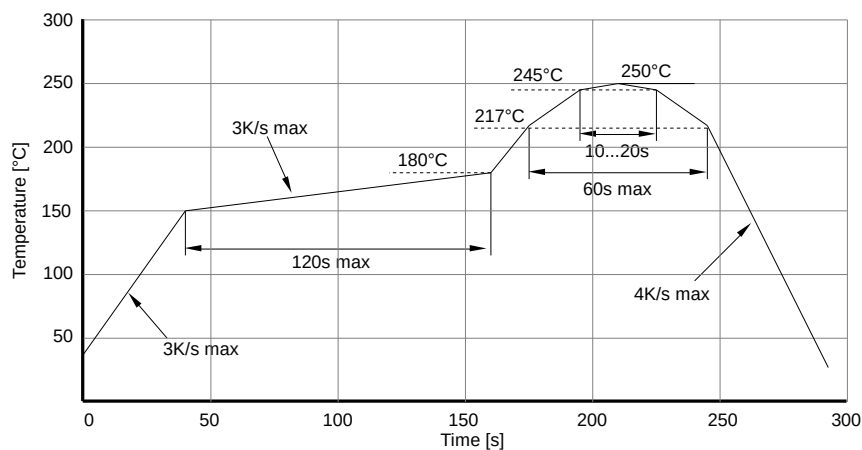
View Angle
Abstrahlung

• Soldering Conditions Lötprofile



IR reflow
soldering
profile for lead
containing
solder

IR Reflow
Lötprozess für
bleihaltiges Lot



IR reflow
soldering
profile for lead
free soldering

IR Reflow
Lötprozess für
bleifreies Lot

Manual Soldering: Manuelles Löten:

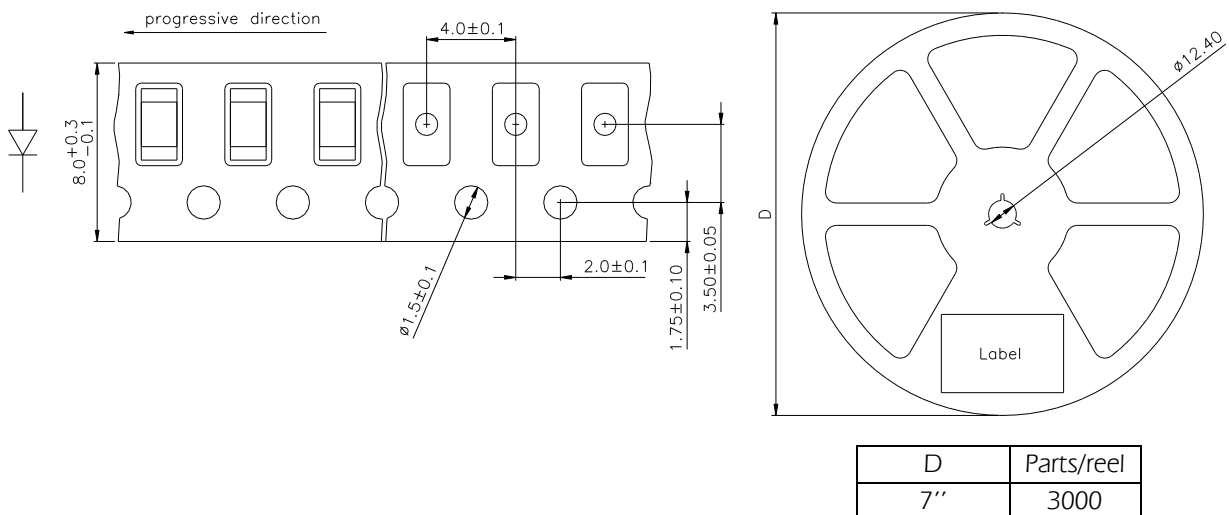
max power of iron 25W / 300°C for 3s
Max. Leistung des Lötkolben 25W / 300°C für 3s

• Ordering Code For Parts Kodierung der Bestellnummer

Series Serie	Color Farbe	Encapsulation Verguss	Packaging Verpackung
OLS-136	-	???????	-
		?	?
			T – taped up
			TD – taped down
		X	– uncolored clear
		XD	– uncolored diffused

Type definition, e.g. OLS-136 MR/HY-XD-T
 Typenbezeichnung z.B. OLS-136 MR/HY-XD-T

• Tape And Reel Packing Gurt und Spule



Packing

The reel is sealed in special plastic bag with integrate ESD protection including a silica dry-pack.

Shelf life for sealed bag 12 month on max. 30°C and 60% Rh.

Floor life 12 month for Europe or 6 months for all other countries on max. 30°C and 60% Rh in a dust free environment.

Other bags (i.e. MBB, HIC, Vacuum pack, etc.) on request.

Verpackung

Die Rolle wird zusammen mit einem Trockenmittelbeutel in einem Highshield-Antistatic-Beutel verschweißt.

Lagerzeit für den verschweißten Beutel beträgt 12 Monate bei max. 30°C und 60% Rh.

Lagerzeit bei geöffnetem Beutel 12 Monate in Europa oder 6 Monate für alle anderen Länder bei max. 30°C und 60% Rh in einer staubfreien Umgebung.

Andere Verpackungen auf Anfrage möglich.

• LED Luminous Intensity Groups And Subgroups [mcd] Lichtstärkeklassen und Unterklassen

(General information – not this device specific)

(Allgemeine Informationen – nicht bauteilspezifisch)

G:	1.80	-	2.80	G1:	1.80	-	2.24
				G2:	2.24	-	2.80
H:	2.80	-	4.50	H1:	2.80	-	3.55
				H2:	3.55	-	4.50
J:	4.50	-	7.10	J1:	4.50	-	5.60
				J2:	5.60	-	7.10
K:	7.10	-	11.20	K1:	7.10	-	9.00
				K2:	9.00	-	11.20
L:	11.20	-	18.00	L1:	11.20	-	14.00
				L2:	14.00	-	18.00
M:	18	-	28	M1:	18.00	-	22.40
				M2:	22.40	-	28.00

Measured according to CIE 127. All SMD-LEDs are 100% measured and selected on full automated equipment with an accuracy of ± 11 %.

Special service: Brightness selection in sub selections possible.

Color selection in 3 sub selections possible (each subgroup per reel).

Gemessen nach CIE127. Alle SMD-LEDs sind 100% gemessen und auf automatischen Anlagen mit einer Toleranz von ± 11 % selektiert.

Spezieller Service: Selektion der Helligkeit in Unterklassen auf Anfrage möglich.

Farbselektion in drei Unterklassen möglich (je eine Unterklasse pro Spule).

Attention please

The information describes the type of component and shall not consider as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change reserved. The data sheet may change without prior information; the valid issue will be on our webpage in internet. Due to technical requirements, components may contain dangerous substances.

Parameters can vary in different applications. The customer must validate all operating parameters for each customer application. EPIGAP OSA Photonics GmbH does not have the responsibility for the reliability and the degradation behavior of products made with EPIGAP OSA Photonics GmbH diodes because they depend not only on the diode but also on the conditions of manufacture or design of the final products. The customer is responsible to approve the long-term stability of the product according to customer's requirements. Components used in toys, life support devices or EPIGAP OSA Photonics GmbH must expressly authorize systems or safety devices or systems for such purpose!

Packaging: EPIGAP OSA Photonics GmbH uses recyclable packages; please use the recycling operators known to you.

Zur Beachtung

Dieses Datenblatt beschreibt typische, nicht uneingeschränkt garantierte Bauelementeigenschaften. Es gelten die AGB der EPIGAP OSA Photonics GmbH, das Recht zur Änderung dieser ist vorbehalten.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten, eine automatische Information erfolgt nicht. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Internet-Seite vorhanden. Auf Grund technischer Erfordernisse können die Bauelemente gefährliche Substanzen enthalten.

Produkteigenschaften können je nach Anwendung variieren. Die Produkteigenschaften müssen in der Anwendung durch den Kunden geprüft werden. EPIGAP OSA Photonics GmbH ist nicht für die Zuverlässigkeit und das Alterungsverhalten von Produkten, die unter Verwendung von der EPIGAP OSA Photonics GmbH hergestellten Dioden gefertigt wurden, verantwortlich, da Beides nicht nur von den Dioden selbst, sondern auch von Konstruktion und Fertigung des Endproduktes abhängt. Der Kunde ist verpflichtet, das Langzeitverhalten des Produktes gemäß seinen Anforderungen zu prüfen und freizugeben. Werden die Dioden in Spielzeug, lebenserhaltenden oder sicherheitsrelevanten Systemen und Geräten eingesetzt, muss dies durch die EPIGAP OSA Photonics GmbH ausdrücklich gestattet werden.

Rückgabe von Verpackungsmaterial: Die EPIGAP OSA Photonics GmbH verwendet wiederverwertbare Verpackung, bitte wenden Sie sich an einen örtlichen Verwerter.

EPIGAP OSA Photonics GmbH

www.epigap-osa.de

Köpenicker Str.325
12555 Berlin Germany
Tel. +49 (0)30 6576 3760
contact@epigap-osa.de